

公司概況資料表

**以下資料由意德士科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

** 認購相關資訊**

**** [**公司簡介**](#公司簡介)

**** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**** [**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

**** [**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

**** [**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：意德士科技股份有限公司 (股票代號：7556)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 永豐金證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 永豐金證券股份有限公司 羅湘萍(02)2382-3255 |
| 註冊地國 | (外國發行人適用) |
| 訴訟及非訟代理人 | (外國發行人適用) |

|  |
| --- |
| 輔導推薦證券商認購意德士科技股份有限公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 玉山綜合證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 民國108年11月4日 |
| 認購股數（股） | 499,000 | 100,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.70% | 0.54% |
| 認購價格 | 每股新台幣50元 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | 目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。(3)收益法：重視公司未來營運所創造之現金流入價值。上述股票評價方法中，股價淨値比法係以歷史成本作為計算依據，受經營期間長短、盈餘分配政策、股東權益結構等因素影響，且未考慮公司未來成長性，故對成長型公司較不具參考性；成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法則須推估某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率及資本支出等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握。故本次輔導推薦證券商認購意德士科技股份有限公司(以下簡稱意德士)僅就市場法中之本益比法進行評估。意德士主係從事半導體零組件之生產與銷售，及提供未來零組件售後市場之再生製造關鍵精密零組件與次系統等維修服務。經參考與意德士從事相同或類似業務之國內上市櫃公司，如京鼎(股票代號：3413)、瑞云(股票代號：6532)及翔名(股票代號：8091)作為該公司之採樣同業。茲就該公司採樣同業最近三個月(108年7月~108年9月)之股價本益比區間列示如下：單位：倍

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　　　　月份採樣同業 | 108年7月 | 108年8月 | 108年9月 | 平均 |
| 京鼎(3413) | 9.75 | 12.55 | 12.61 | 11.64  |
| 瑞云(6532) | 8.67 | 10.34 | 10.27 | 9.76  |
| 翔名(8091) | 12.92 | 13.59 | 12.98 | 13.16  |
| 上市股票-半導體類 | 19.28 | 20.57 | 21.51 | 20.45 |
| 上櫃股票-半導體類 | 17.68 | 18.53 | 18.65 | 18.29 |

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站依上表所示，該公司採樣同業及上市櫃股票-半導體類最近三個月(108年7月~108年9月)之平均本益比區間約為9.76~20.45倍之間，去除極端值後平均本益比區間為11.64~18.29倍，若以該公司107年度經會計師查核簽證之稅後每股盈餘3.55元，按上述本益比區間計算其參考價格，價格區間約為41.32~64.93元，由本證券承銷商與意德士共同議定認購價格為每股50元，尚介於採樣同業及上市櫃股票-半導體類股本益比區間，故與意德士議定之認購價應尚屬合理。綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除採用國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並參酌該公司之所屬產業、發行市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況等因素後，由興櫃推薦證券商與意德士共同議定興櫃認購價格為50元，應屬合理。 |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| 一、公司介紹意德士科技股份有限公司(以下簡稱意德士)設立於民國88年7月15日，主係從事半導體零組件(如全氟化橡膠密封材O-RING、精密陶瓷零組件、曝光載台E-TABLE)之生產與銷售，及提供未來零組件售後市場之再生製造關鍵精密零組件與次系統等維修服務(如靜電吸盤E-CHUCK、陶瓷加熱器HEATER及曝光載台E-TABLE)，主要應用於半導體產業、平面顯示器產業、發光二極體產業、模組產業、太陽能電池產業、汽車產業、生醫產業及特殊材料應用產業，在半導體等高精密度與嚴格製程控制的產業中，公司能夠提供客戶需求導向的客製化產品與服務，以求精確符合使用者需求。意德士主要業務範圍以大中華地區為主，為深入在大中華區發展半導體、平面顯示器等相關產業之製程設備關鍵零組件，達到其關鍵零組件供貨在地化策略(localization)，意德士與國外策略聯盟合資設立製造工廠，建立嚴謹的品質系統並通過ISO認證及設備原廠認證，同時深化產品之技術開發與製造供應能量，以期能推進相關領域之亞太與全球運籌物流供應鏈為目標。二、歷史沿革

|  |  |
| --- | --- |
| 年 | 重要沿革 |
| 88年7月 | 意德士科技股份有限公司正式成立，設立實收資本額為500萬元整。 |
| 88年8月 | 成為日本Nihon Ceratec株式會社之台灣地區總代理銷售商，另外在新竹縣成立新竹區業務服務辦公室。 |
| 88年9月 | 開始供貨給半導體晶圓大廠，成為Etch/Thin film製程使用精密陶瓷零組件之合格供應商。 |
| 89年9月 | 與半導體客戶合作，開發其CVD薄膜製程使用之靜電吸盤與陶瓷加熱器之再生製造與維修校正工程，並成功開始供貨。 |
| 91年10月 | 台北總公司遷移至台北市中山區松江路158號8樓之5。 |
| 92年8月 | 成為日本大金工業株式會社之DUPRA全氟橡膠密封材產品台灣地區總代理銷售商。 |
| 92年11月 | 現金增資新台幣2,450萬元，公司增資後實收資本額為新台幣2,950萬元整。 |
| 96年7月 | 成立台南區業務服務辦公室。 |
| 97年2月 | 與日本Nihon Ceratec株式會社設立策略聯盟誼特科技股份有限公司，並設廠於新竹科學園區(以下簡稱誼特科學園區工廠)，引進日本技術，在地化製造半導體設備使用之靜電吸盤與陶瓷加熱器。本公司成為誼特公司之大中華區總代理，開始開拓中國大陸市場。 |
| 98年12月 | 本公司與半導體業客戶合作，開發其曝光裝置使用之晶圓吸盤，並成功開始供貨。 |
| 100年12月 | 盈餘轉增資2,065萬元，公司增資後實收資本額為新台幣5,015萬元整。 |
| 101年5月 | 本公司投資成立子公司大鐿先端科技股份有限公司，設廠於竹東(以下簡稱大鐿竹東工廠)開始研發與製造半導體設備使用之氟橡膠密封材產品。 |
| 102年1月 | 大鐿竹東工廠，於102年1月通過ISO 9001:2008認證。 |
| 102年2月 | 本公司引進日本Nihon Ceratec株式會社之高密度電漿陶瓷熔射設備與技術在地化製造，生產半導體設備使用之奈米級線徑製程之腔體零組件。 |
| 102年5月 | 子公司大鐿先端科技股份有限公司與日本大金工業株式會社簽訂氟橡膠之密封材產品的開發及技術協作合約。 |
| 103年9月 | 大鐿竹東工廠YEEDEX自製品牌-全氟橡膠密封材產品成功開始供貨半導體晶圓大廠之Etching機台設備使用。大鐿竹東工廠進行擴建，增加全氟橡膠密封材產品成形設備及產能。 |
| 104年9月 | 大鐿竹東工廠YEEDEX自製品牌-全氟橡膠密封材產品成功開始供貨N10奈米製成機台設備使用。 |
| 105年4月 | 本公司成為日本大金工業株式會社之子公司東邦化成株式會社之DUPRA產品中國大陸地區代理銷售商。 |
| 105年6月 | 本公司與日本NTK Ceratec株式會社簽訂N10奈米曝光製程用零組件共同技術開發合約。 |
| 105年7月 | 盈餘轉增資1,675萬元，財產抵繳股款3,310萬，公司增資後實收資本額為新台幣1億元整。 |
| 105年7月 | 本公司投資誼特科技股份有限公司之49%股權，誼特科技股份有限公司成為關聯企業。 |
| 105年9月 | 大鐿竹東工廠通過中國大陸半導體晶圓大廠之工廠實地稽核。 |
| 106年3月 | 大鐿竹東工廠，於106年3月通過 ISO 9001:2015認證。 |
| 106年5月 | 台北總公司遷移至現址[台北市中山區民生東路2段170號4樓]。 |
| 106年12月 | 大鐿竹東工廠進行第二期擴建，建置class 100原料區。 |
| 107年6月 | 盈餘轉增資6,000萬元，公司增資後實收資本額為新台幣1.6億元整。 |
| 107年7月 | 本公司投資子公司大鐿先端科技股份有限公司剩餘之50%股權，該公司成為100%子公司。 |
| 107年7月 | 現金增資暨創櫃板登錄前之籌資，合計1,000萬元，公司增資後實收資本額為新台幣1.7億元整；登錄創櫃板，意德士科技股份有限公司股票代號為7556。 |
| 107年11月 | 購入竹東工業區廠房1,400餘坪與土地1,100餘坪，進行生產線整合與擴建產能計劃。 |
| 108年6月 | 現金增資新台幣1,500萬元，公司增資後實收資本額為新台幣18,500萬元整。 |
| 108年8月 | 經證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。 |

三、經營理念「品質嚴格控制、交期符合時效、即時客戶服務」為意德士對客戶的長期三大承諾與保證。成為“ 熱誠努力不懈的專業團隊”是意德士的基本精神。在過去數年以來，意德士已經與客戶及供應鏈夥伴們成功的建立了雙贏關係，並秉持著不變的熱情與意志，希望能繼續與各地新的客戶與供應商，建立長久的夥伴關係。四、未來展望1.短期業務發展計畫(1)現有半導體設備零組件相關之產品拓展行銷，提高市場之佔有率，加強提供客戶即時服務與技術支援。(2)加深與國外策略伙伴之關係，加速爭取更先進的策略性產品，充足產品線。(3)積極拓展中國大陸市場之銷售，建立戰略夥伴，共同經營市場。2.長期業務發展計畫(1)深化關鍵零組件供貨在地化策略(localization enhancing)。(2)擴大供給亞太與全球運籌物流供應鏈(global supplying)。(3)滿足大中華區客戶需求導向的產品與服務(customer-oriental)(4)串聯日本美國先進上下游供應鏈，開發新領域(new fields)應用之客製化產品 |

 

|  |
| --- |
| **主要業務項目：**主係從事半導體零組件之生產與銷售，及提供未來零組件售後市場之再生製造關鍵精密零組件與次系統等維修服務。 |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：半導體產業鏈上游為IP設計及IC設計業，中游為IC製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，下游為IC封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC模組、IC通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。flow.png |
| 產品名稱 | 產品圖示及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一(107)年度營收金額(仟元) | 占總營收比重(%) |
| 半導體零組件 | 全氟化橡膠密封材ceramic精密陶瓷零組件oring | * 應用於半導體產業、平面顯示器產業之薄膜製程、蝕刻製程、擴散製程等相關機台與廠務配管使用。
* 應用於半導體產業、平面顯示器產業、 發光二極體產業、太陽能電池及特殊電子模組元件產業之薄膜製程、蝕刻製程、擴散製程、黃光製程、打線接合製程、晶圓切割製程與封裝製程等相關機台使用。
 | 266,068  | 77.26 |
| 維修收入 | 再生製造精密零組件與次系統 | * 應用於半導體產業薄膜製程、蝕刻製程、黃光製程與擴散製程之相關機台使用。
* 應用於再生製造與維修校正製程設備中之貴重精密零組件如靜電吸盤、陶瓷加熱器、真空吸盤、陶瓷覆膜、陽極處理等。
 | 69,441  | 20.16 |
| 其他 | **-** | **-** | 8,892  | 2.58 |
| 合 計 | 344,401 | 100.00 |

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表** 單位：新台幣仟元  |
| 年度項目 | 103年(註1) | 104年(IFRS) | 105年(IFRS)(註2) | 106年(IFRS)(註2) | 107年(IFRS)(註2) |  108年截至 9 月份止**(自結數)****(註3)** |
| 營業收入 | 不適用 | 233,618 | 231,899 | 298,756 | 344,401 | 285,322 |
| 營業毛利 | 78,206 | 80,592 | 102,639 | 128,176 | 114,483 |
| 毛利率(%) | 33.48 | 34.75 | 34.36 | 37.22 | 40.12 |
| 營業外收入 | 3,686 | 2,160 | 10,104 | 11,288 | 7,194 |
| 營業外支出 | － | (210) | (6,119) | (381) | (3,457) |
| 稅前損益 | 39,998  | 39,464 | 60,148 | 81,892 | 70,701 |
| 稅後損益 | 33,438 | 33,329 | 47,365 | 66,289 | 53,219 |
| 每股盈餘（元） | 2.90 | 2.23 | 2.74 | 3.55 | 2.98 |
| 股利發放 | 現金股利(元) | 2.64 | － | 3 | 2 | － |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | － | － | － | － | － |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | 3.34 | － | 6 | － | － |

註1：103年度並未有依據國際財務報導準則之財務資訊。

註2：本公司自105年1月1日起首次適用國際財務報導準則，105、106及107年度財務資料均經會計師查核簽證。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**單位：新台幣仟元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 103年 | 104年(IFRS) | 105年(註2) | 106年(註2) | 107年(註2) |
| 流動資產 | 不適用 | 234,183 | 282,757 | 332,926 | 321,897 |
| 基金及長期投資 | － | 27,219 | 30,751 | 33,405 |
| 固定資產 | 6,667 | 4,955 | 8,398 | 155,187 |
| 無形資產 | 199 | 107 | 5,094 | 2,680 |
| 其他資產 | 771 | 779 | 1,380 | 852 |
| 資產總額 | 241,820 | 315,817 | 378,549 | 514,021 |
| 流動負債 | 分 配 前 | 83,250 | 104,095 | 119,878 | 122,485 |
| 分 配 後 | 96,500 | 104,095 | 149,878 | 159,485 |
| 長期負債 | － | － | － | 100,000 |
| 其他負債 | 3,350 | 3,323 | 3,076 | 3,379 |
| 負債總額 | 分 配 前 | 86,600 | 107,418 | 122,954 | 225,864 |
| 分 配 後 | 99,850 | 107,418 | 152,954 | 262,864 |
| 股本 | 50,150 | 100,000 | 100,000 | 170,000 |
| 資本公積 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 14,858 |
| 法定盈餘公積 | 15,012 | 18,239 | 21,887 | 25,816 |
| 保留盈餘 | 分 配 前 | 77,191 | 72,775 | 113,266 | 77,483 |
| 分 配 後 | 63,941 | 72,775 | 83,266 | 40,483 |
| 非控制權益 | 11,128 | 15,646 | 18,703 | － |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | － | － | － | － |
| 累積換算調整數 | － | － | － | － |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | 155,220 | 208,399 | 255,595 | 288,157 |
| 分 配 後 | 141,970 | 208,399 | 225,595 | 251,157 |

註1：103年度並未有依據國際財務報導準則之財務資訊。

註2：本公司自105年1月1日起首次適用國際財務報導準則，105、106及107年度財務資料均經會計師查核簽證。

|  |
| --- |
| **最近三年度財務比率** |
| 年 度項 目 | 105年(IFRS) | 106年(IFRS) | 107年(IFRS) |
| **財****務****比****率** | 毛利率(%) | 34.75 | 34.36 | 37.22 |
| 流動比率(%) | 271.63  | 277.72  | 262.81 |
| 應收帳款天數(天) | 65 | 55 | 57 |
| 存貨週轉天數(天) | 45  | 38  | 38  |
| 負債比率(%) | 34.01  | 32.48  | 43.94  |

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!